



2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年11月14日

上場会社名 タツモ株式会社 上場取引所 東
コード番号 6266 URL <https://tazmo.co.jp/ir/library/#irlib-report01>
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 泰之
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 吉國 久雄 TEL 086-239-5000
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無：無

（百万円未満切捨て）

1. 2025年12月期第3四半期の連結業績（2025年1月1日～2025年9月30日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2025年12月期第3四半期	27,114	9.6	4,423	△3.9	4,454	△1.5	3,175	2.6
2024年12月期第3四半期	24,739	30.0	4,601	91.3	4,524	68.2	3,094	101.1

（注）包括利益 2025年12月期第3四半期 2,616百万円（19.1％） 2024年12月期第3四半期 3,233百万円（46.3％）

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年12月期第3四半期	218.95	—
2024年12月期第3四半期	211.27	—

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	％	円 銭
2025年12月期第3四半期	47,811	26,306	54.1	1,788.03
2024年12月期	49,200	24,642	49.1	1,649.40

（参考）自己資本 2025年12月期第3四半期 25,874百万円 2024年12月期 24,176百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年12月期	—	0.00	—	33.00	33.00
2025年12月期	—	0.00	—		
2025年12月期（予想）				34.00	34.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2025年12月期の連結業績予想（2025年1月1日～2025年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
通期	36,000	0.4	5,000	△15.5	5,100	△15.0	3,500	△17.6	241.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、本日（2025年11月14日）に公表いたしました、「2025年12月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無
新規 ー社 (社名) ー、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2025年12月期 3 Q	14, 842, 354株	2024年12月期	14, 842, 354株
② 期末自己株式数	2025年12月期 3 Q	371, 646株	2024年12月期	184, 897株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年12月期 3 Q	14, 503, 822株	2024年12月期 3 Q	14, 647, 170株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(重要な後発事象)	8
(四半期連結貸借対照表に関する注記)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9
(セグメント情報等の注記)	10
3. 補足情報	11
(受注状況)	11

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間における経営環境は、地政学リスクの高まり、原材料の高騰や不安定な為替相場など、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループが属する半導体業界におきましては、引き続き生成AIに関連したサーバーへの設備投資が拡大しており、アドバンスドパッケージ向けの半導体装置の需要が市場をけん引いたしました。

このような状況のなか当社グループは、中長期的な成長に向けて、顧客ニーズに対応した装置の開発や生産活動に注力してまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は271億14百万円（前年同期比9.6%増）、営業利益44億23百万円（前年同期比3.9%減）、経常利益44億54百万円（前年同期比1.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益31億75百万円（前年同期比2.6%増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

(プロセス機器事業)

半導体装置部門につきましては、概ね計画通りに推移しており、売上高は129億31百万円（前年同期比29.8%増）となりました。

搬送装置部門につきましては、半導体メーカーの設備投資が鈍化している影響を受け、売上高は56億92百万円（前年同期比2.9%減）となりました。

洗浄装置部門につきましては、ウェーハメーカーの設備投資が鈍化している影響を受け、売上高は13億43百万円（前年同期比64.2%減）となりました。

コーター部門につきましては、FPD関連の新規設備投資がないことから、売上高は5億64百万円（前年同期比69.6%減）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は205億33百万円（前年同期比4.2%減）、営業利益35億66百万円（前年同期比20.6%減）となりました。

(金型・樹脂成形事業)

金型・樹脂成形事業につきましては、コネクタメーカーの在庫調整が解消されつつあることから、売上高は9億15百万円（前年同期比84.9%増）、営業利益95百万円（前年同期は2億17百万円の営業損失）となりました。

(表面処理用機器事業)

表面処理用機器事業につきましては、受注していた案件が順調に検収となり、売上高は56億66百万円（前年同期比101.9%増）、営業利益7億33百万円（前年同期比127.6%増）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は390億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億57百万円減少しました。主な要因は、「現金及び預金」の増加56億44百万円、「受取手形及び売掛金」の減少21億85百万円、「電子記録債権」の減少9億78百万円、「棚卸資産」の減少40億89百万円によるものであります。有形固定資産は76億74百万円となり、前連結会計年度末より2億89百万円増加しました。主な要因は、「建物及び構築物」の減少1億41百万円、「機械装置及び運搬具」の増加3億12百万円、「その他」の増加1億18百万円によるものであります。無形固定資産は1億64百万円となり、前連結会計年度末より7百万円増加しました。主な要因は、「ソフトウェア」の増加4百万円、「その他」の増加3百万円によるものであります。投資その他の資産は8億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少しました。主な要因は、「繰延税金資産」の増加11百万円、「その他」の減少44百万円によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億88百万円減少し、478億11百万円となりました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は153億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億42百万円の減少となりました。主な要因は、「電子記録債務」の減少25億85百万円、「未払法人税等」の減少6億79百万円、「契約負債」の増加8億23百万円によるものであります。固定負債は61億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億10百万円の減少となりました。主な要因は、「長期借入金」の減少6億51百万円によるものであります。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ30億53百万円減少し、215億4百万円となりました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は263億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億64百万円の増加となりました。主な要因は、「利益剰余金」の増加26億85百万円、「自己株式」の取得に伴う減少4億48百万円、「為替換算調整勘定」の減少5億30百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループにおきましては、半導体業界の中でも設備投資が堅調に推移しているアドバンスドパッケージ向け半導体製造装置を中心に事業を進めておりますが、2025年12月期の連結業績は、出荷済み装置の検収遅れや、受注状況が想定以上に悪化したことなどにより売上高は計画を下回る見込みとなりました。このことにより利益につきましても計画を下回る見込みとなりました。

このような状況を踏まえ、2025年2月14日に公表しました、2025年12月期連結業績予想数値を修正いたします。

詳細につきましては、本日（2025年11月14日）に公表いたしました、「2025年12月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,343,286	15,988,013
受取手形及び売掛金	※1 5,683,858	3,498,063
電子記録債権	※1 3,542,623	2,564,519
棚卸資産	20,294,399	16,205,049
その他	961,714	834,708
貸倒引当金	△94,775	△16,500
流動資産合計	40,731,106	39,073,854
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,794,802	3,653,506
機械装置及び運搬具（純額）	1,293,213	1,605,706
土地	1,449,362	1,449,516
その他（純額）	847,712	966,257
有形固定資産合計	7,385,091	7,674,987
無形固定資産		
ソフトウェア	112,907	117,317
その他	43,429	46,771
無形固定資産合計	156,337	164,088
投資その他の資産		
投資有価証券	26,271	24,839
繰延税金資産	466,944	478,713
その他	439,856	395,010
貸倒引当金	△5,213	—
投資その他の資産合計	927,859	898,562
固定資産合計	8,469,288	8,737,639
資産合計	49,200,394	47,811,493

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,636,795	1,455,497
電子記録債務	3,906,060	1,320,839
短期借入金	2,813,108	3,232,480
未払金	1,563,704	1,000,646
未払法人税等	1,213,001	533,550
契約負債	5,252,062	6,075,773
賞与引当金	393,851	631,220
製品保証引当金	611,459	623,270
株式給付引当金	9,266	9,106
その他	297,057	471,124
流動負債合計	17,696,367	15,353,510
固定負債		
長期借入金	5,980,749	5,329,270
株式給付引当金	314,235	337,123
役員退職慰労引当金	30,447	33,892
退職給付に係る負債	77,171	80,618
資産除去債務	208,764	196,365
その他	250,225	174,161
固定負債合計	6,861,593	6,151,432
負債合計	24,557,961	21,504,942
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,568,590	3,568,590
資本剰余金	3,430,399	3,420,931
利益剰余金	16,089,096	18,774,943
自己株式	△293,919	△742,088
株主資本合計	22,794,167	25,022,377
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△289	△404
為替換算調整勘定	1,382,193	852,085
その他の包括利益累計額合計	1,381,904	851,680
非支配株主持分	466,361	432,492
純資産合計	24,642,433	26,306,550
負債純資産合計	49,200,394	47,811,493

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)
売上高	24,739,724	27,114,192
売上原価	16,078,238	18,601,773
売上総利益	8,661,486	8,512,418
販売費及び一般管理費	4,060,342	4,088,943
営業利益	4,601,144	4,423,475
営業外収益		
受取利息	33,537	54,468
補助金収入	918	111,728
その他	14,261	26,403
営業外収益合計	48,718	192,600
営業外費用		
支払利息	59,620	64,401
為替差損	58,820	71,145
その他	7,414	26,170
営業外費用合計	125,855	161,717
経常利益	4,524,006	4,454,358
特別利益		
固定資産売却益	3,756	16,885
特別利益合計	3,756	16,885
特別損失		
投資有価証券評価損	43,862	—
減損損失	100,011	—
特別退職金	33,218	—
特別損失合計	177,092	—
税金等調整前四半期純利益	4,350,670	4,471,243
法人税等	1,226,253	1,280,472
四半期純利益	3,124,416	3,190,770
非支配株主に帰属する四半期純利益	29,946	15,188
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,094,470	3,175,581

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)
四半期純利益	3,124,416	3,190,770
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△293	△115
為替換算調整勘定	109,777	△573,715
持分法適用会社に対する持分相当額	—	△61
その他の包括利益合計	109,483	△573,891
四半期包括利益	3,233,900	2,616,879
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,201,073	2,645,358
非支配株主に係る四半期包括利益	32,827	△28,479

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表に関する注記)

※1 期末日満期手形等の処理

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等の金額が前連結会計年度末日の残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日)
受取手形	1,442千円	－千円
電子記録債権	295,827千円	－千円

2 電子記録債権譲渡高

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年9月30日)
電子記録債権譲渡高	25,886千円	－千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年9月30日)
減価償却費	620,705千円	703,014千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間（自 2024年1月1日 至 2024年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用機 器事業			
売上高						
半導体装置	9,964,169	—	—	9,964,169	—	9,964,169
搬送装置	5,862,527	—	—	5,862,527	—	5,862,527
洗浄装置	3,756,289	—	—	3,756,289	—	3,756,289
コーター	1,855,970	—	—	1,855,970	—	1,855,970
金型・樹脂成形	—	494,853	—	494,853	—	494,853
表面処理用機器	—	—	2,805,913	2,805,913	—	2,805,913
顧客との契約から生じる 収益	21,438,958	494,853	2,805,913	24,739,724	—	24,739,724
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	21,438,958	494,853	2,805,913	24,739,724	—	24,739,724
セグメント間の内部売上 高又は振替高	285,813	193,024	—	478,838	△478,838	—
計	21,724,771	687,877	2,805,913	25,218,562	△478,838	24,739,724
セグメント利益又は損失 (△)	4,491,106	△217,373	322,162	4,595,896	5,247	4,601,144

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

II 当第3四半期連結累計期間（自 2025年1月1日 至 2025年9月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業	表面処理用機 器事業			
売上高						
半導体装置	12,931,464	—	—	12,931,464	—	12,931,464
搬送装置	5,692,874	—	—	5,692,874	—	5,692,874
洗浄装置	1,343,885	—	—	1,343,885	—	1,343,885
コーター	564,776	—	—	564,776	—	564,776
金型・樹脂成形	—	915,058	—	915,058	—	915,058
表面処理用機器	—	—	5,666,133	5,666,133	—	5,666,133
顧客との契約から生じる 収益	20,533,001	915,058	5,666,133	27,114,192	—	27,114,192
その他の収益	—	—	—	—	—	—
外部顧客への売上高	20,533,001	915,058	5,666,133	27,114,192	—	27,114,192
セグメント間の内部売上 高又は振替高	238,727	50,526	—	289,253	△289,253	—
計	20,771,728	965,584	5,666,133	27,403,446	△289,253	27,114,192
セグメント利益	3,566,717	95,134	733,159	4,395,011	28,463	4,423,475

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に係る未実現利益の調整であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3. 補足情報

(受注状況)

当第3四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

1. 受注高

セグメントの名称		前第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日) (千円)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年9月30日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業		14,564,722	14,770,629	101.4
	半導体装置	7,389,511	8,321,351	112.6
	搬送装置	5,741,447	4,994,162	87.0
	洗浄装置	1,134,182	1,017,932	89.8
	コーター	299,581	437,182	145.9
金型・樹脂成形事業		483,257	915,629	189.5
表面処理用機器事業		2,184,788	2,333,193	106.8
合計		17,232,768	18,019,452	104.6

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 受注残高

セグメントの名称		前第3四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年9月30日) (千円)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年9月30日) (千円)	前年同期比 (%)
プロセス機器事業		24,466,570	19,642,210	80.3
	半導体装置	14,840,485	13,423,084	90.4
	搬送装置	4,243,231	3,026,738	71.3
	洗浄装置	3,612,021	1,982,170	54.9
	コーター	1,770,832	1,210,216	68.3
金型・樹脂成形事業		144,632	170,761	118.1
表面処理用機器事業		7,866,047	2,240,332	28.5
合計		32,477,250	22,053,304	67.9

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。